

# Repair Stick Kupfer



### sehr schnell härtend kupfergefüllt NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

WEICON Repair Stick Kupfer eignet sich für sehr schnelle (Verarbeitungszeit 3 Min.) Reparaturen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten auch auf feuchten und nassen Flächen, wie Rohren und Rohrbögen, Fittings und Flanschen, Kupferrinnen und -blechen, Wassererhitzern und Wassertanks, Warm- und Kaltwasserleitungen, Gefrier- und Klimaanlagen.

WEICON Repair Stick Kupfer kann im Behälter- und Apparatebau. in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.



## **Technische Daten**

Basis	Epoxidharz, kupfergefüllt
Beschaffenheit	pastös
Farbe nach der Aushärtung	kupfer
Mischungsverhältnis nach Volumen Harz/Härter	1:1
Dichte der Mischung	1,9 g/cm <sup>3</sup>
Spaltüberbrückung bis max.	15 mm
	+10 bis +30 °C
Aushärtungstemperatur	+6 bis +40 °C
Topfzeit bei 25g Ansatzmenge und +20°C (+68°F)	3 min.
Handfest (35%Festigkeit) nach	10 min.
Mechanisch belastbar (50% Festigkeit) nach	60 min.
Endhärte (100% Festigkeit) nach	24 Std
Druckbelastung	80 N/mm²
mittlere Zugscherfestigkeit nach 7 Tagen	Kupfer sandgestrahlt: 4,8 N/mm²

bei +20°C (+68°F) nach DIN 532832 an

Shore Härte D	80
Wärmeleitfähigkeit (ASTM D 257)	0,7 W/m.K
Lineare Schrumpfung	<1 %
Elektrischer Widerstand (ASTM D 257)	5•10 <sup>11</sup> Ohm/cm
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (ASTM D 149)	3,0 kV/mm
Wärmeausdehnungskoeffizient (ISO 11359)	30-40 x 10^-6 K^-1
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +120 kurzf. +150 °C
ISSA-Code	75.530.04/05
IMPA-Code	812975/76

#### Oberflächenvorbehandlung

Voraussetzung für eine einwandfreie Haftung sind saubere und trockene Oberflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).

#### Verarbeitung

WEICON Repair Sticks überbrücken pro Arbeitsgang einen Klebespalt bis max. 15 mm. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 25 g bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxydharzen (exotherme Reaktion) eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.

#### Lagerung

WEICON Repair Sticks sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden.

#### Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

### Erhältliche Gebindegrößen:

Repair Stick Kupfer 57 g 10530057 10530115 Repair Stick Kupfer 115 g

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibendeh hohe Qualifät unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch auschiende Eigensversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.